

天津金海通半导体设备股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要

(上接 C7版)

如公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;
(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

董事会制定利润分配方案时,综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段,以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则:
(1)在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到80%;
(2)在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到40%;
(3)在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。公司应当及时行使对全资子公司股东的权利,根据全资子公司公司章程的规定,促成全资子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

4. 股票股利分配的条件
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

公司采取股票股利分配相结合的方式分配利润时,应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

5. 利润分配的时间间隔
在满足现金分红条件的情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议进行中期现金分红。

6. 利润分配应履行的程序
公司具体利润分配方案由公司董事会向股东大会提出。董事会制定的利润分配方案经董事会过半数(其中应包含二分之一以上的独立董事)表决通过,监事会半数以上监事表决通过,董事会在利润分配方案中说明留存未分配利润的使用计划,独立董事应当在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见。公司利润分配方案经董事会、监事会审议通过,并由董事会需提交公司股东大会审议。

涉及利润分配相关议案,公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

公司股东大会在利润分配方案执行前,应当通过多种渠道与公众投资者、特别是中小投资者进行沟通交流,充分听取公众投资者的意见与诉求。公司董事会秘书及时将有关意见汇总并在审议利润分配方案的董事会上予以说明。

公司在满足现金分红条件的情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议进行中期现金分红。

7. 利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确有必要调整或变更利润分配政策(包括股东回报规划)的,应经详细论证,调整后利润分配政策不得损害股东利益,不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

如需调整利润分配政策,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,有关调整利润分配政策的议案,需事先征求独立董事及监事会的意见,利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数(其中包含二分之一以上独立董事)表决通过并经三分之二以上董事表决通过,监事会审议通过,利润分配政策调整方案,由董事会提交股东大会审议。

董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因,股东大会审议公司利润分配政策调整议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

为充分听取中小股东意见,公司应通过多种渠道与公众投资者,特别是中小投资者进行沟通交流,并通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

8. 其他
公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

本次发行前后股利分配政策不存在重大差异情况。

2. 发行人报告期内股利分配情况
报告期内,发行人未进行股利分配。

3. 本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序
2021年5月15日,发行人召开的2021年第二次临时股东大会会议决议,公司本次公开发行股票滚存未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由本次公开发行的新老股东按持股比例共同享有。

十、发行人的子公司、孙公司、参股公司及分公司情况
(一)发行人的子公司、孙公司情况
截止本招股说明书摘要签署日,发行人下属拥有上海海博、天津芯志、江苏金海通、香港金海通、新加坡金海通5家子公司以及马来西亚金海通1家孙公司。

1. 上海海博

公司名称	上海海博半导体设备有限公司	
统一社会信用代码	9131010106798280C	
注册资本	900.00万元	
实缴资本	900.00万元	
成立日期	2013年5月3日	
注册地址	上海市青浦区华新镇徐泾中路2188号1幢一层	
主要生产经营场所	上海市青浦区华新镇徐泾中路2188号	
股东构成及控制情况	金海通持股100.00%	
法定代表人	张宇峰	
经营范围	自动控制系统集成装置、电子元器件、半导体一体化领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、半导体设备相关领域零件加工生产,半导体设备质量检测,电子元器件、机械配件、机电设备销售,从事货物进出口、技术进出口、机电产品进出口贸易,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动	
主营业务	零部件加工及组件装配	
主要财务数据(单位:万元)		
项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	3,096.34	3,030.12
净资产	1,494.57	1,668.56
净利润	-174.00	494.86
审计情况	经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计	

2. 天津芯志

公司名称	天津芯志科技有限公司	
统一社会信用代码	91120116MA6Q8XU	
注册资本	1,000.00万元	
实缴资本	250.00万元	
成立日期	2019年6月25日	
注册地址	天津滨海新区高新区产业区南泰路18号2-504工业孵化-2	
主要生产经营场所	天津滨海新区高新区产业区南泰路18号2-504工业孵化-2	
股东构成及控制情况	金海通持股100.00%	
法定代表人	张宇峰	
经营范围	自动控制系统集成装置、计算机软硬件、机电一体化技术开发、咨询、服务、转让;电子元器件、机械配件、机电设备销售;进出口业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动	
主营业务	软件开发	
主要财务数据(单位:万元)		
项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	223.48	246.31
净资产	22.07	24.24
净利润	-22.17	-10.64
审计情况	经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计	

3. 江苏金海通

公司名称	江苏金海通半导体设备有限公司	
统一社会信用代码	91320691MA2DM9BF9J	
注册资本	7,000.00万元	
实缴资本	4,480.00万元	
成立日期	2019年12月17日	
注册地址	南通市开发区广海路42号330室	
主要生产经营场所	金海通持股100.00%	
股东构成及控制情况	张宇峰	
法定代表人	张宇峰	
经营范围	自动控制系统集成装置、计算机软硬件、机电一体化技术开发、咨询、服务、转让;电子元器件、机械配件、机电设备销售;进出口业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动	
主营业务	尚未经营,计划作为募投项目的实施主体	
主要财务数据(单位:万元)		
项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	3,715.66	701.79
净资产	2,100.13	701.79
净利润	-11.66	-8.21
审计情况	经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计	

4. 香港金海通

公司名称	JHT DESIGNLIMITED	
商业登记号/公司注册号	2680028	
已发行股本	100.00万美元	
成立日期	2018年4月13日	
注册地址	6/F, Manulife Place, 348 Kwan Tong Road, Kowloon, HK	
主要生产经营场所	6/F, Manulife Place, 348 Kwan Tong Road, Kowloon, HK	
股东构成及控制情况	金海通持股100.00%	
法定代表人	张宇峰	
经营范围	半导体设备、机械配件、机电一体化技术咨询、服务、转让及售后服务;货物及技术进出口业务。	
主营业务	市场开拓及售后服务	
主要财务数据(单位:万元)		
项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	539.24	535.85
净资产	513.08	498.24
净利润	-11.01	-26.61
审计情况	经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计	

5. 新加坡金海通

公司名称	JHT DESIGN PTE.LTD	
商业登记号/公司注册号	201901672K	
已发行股本	5.00万新加坡元	
成立日期	2019年11月14日	
注册地址	790 Woodlands Avenue 6, #01-659, Singapore 730790	
主要生产经营场所	790 Woodlands Avenue 6, #01-659, Singapore 730790	
股东构成及控制情况	金海通持股100%	
经营范围	半导体设备、机械配件、机电一体化技术咨询、服务、转让及售后服务;货物及技术进出口业务。	
主营业务	市场开拓及售后服务	
主要财务数据(单位:万元)		
项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	18.26	42.68
净资产	-0.85	29.50
净利润	-30.52	16.38
审计情况	经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计	

6. 马来西亚金海通

公司名称	JHT DESIGN Sdn. BHD	
商业登记号/公司注册号	201601039754210695-K	
已发行股本	2.00令吉	
成立日期	2016年11月29日	
注册地址	19, Irving Road, George Town, Pulau Pinang, 10400, Malaysia	
主要生产经营场所	109-2-17, Gold Coast Condominium, Perivara Bayan Indah, Bayan Lepas11900, Pulau Pinang, Malaysia	
股东构成及控制情况	香港金海通持股100%,金海通间接持股100%	
经营范围	半导体设备、机械配件、机电一体化技术咨询、服务、转让及售后服务;货物及技术进出口业务。	
主营业务	市场开拓及售后服务	
主要财务数据(单位:万元)		
项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	25.09	13.97
净资产	15.26	5.97
净利润	9.24	7.88
审计情况	经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计	

(二)发行人的分公司情况
截止本招股说明书摘要签署日,发行人拥有1家分公司。

1. 上海分公司

名称	天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司
成立日期	2018年11月15日
统一社会信用代码	91310112MA1G8XU56L
经营场所	上海市浦东新区华新镇徐泾中路2188号1幢二层
负责人	张宇峰
经营范围	从事半导体设备、机械配件、机电一体化领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、半导体设备相关领域零件加工生产,半导体设备质量检测,电子元器件、机械配件、机电设备销售,从事货物进出口、技术进出口、机电产品进出口贸易,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

四、募集资金运用

一、本次募集资金投资项目概况及审批情况
公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。公司本次募集资金围绕主营业务进行,全部用于公司主营业务相关的项目,本次募集资金到位后,按轻重缓急顺序安排如下项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	建设期	实施主体
1	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	43,615.04	43,615.04	36个月	发行人
2	年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目	11,066.15	11,066.15	24个月	江苏金海通
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	-	发行人
	合计	74,681.19	74,681.19	-	-

上述项目预计投资总额74,681.19万元,其中募集资金投资额74,681.19万元,拟通过本次公开发行股票募集资金解决。

本次发行实际募集资金金额与项目需要的投资总额之间如存在资金缺口,将由公司自筹或通过银行贷款予以解决。项目实施期内流动资金不足部分将通过公司自有资金补充。

本次募集资金投资项目履行的审批备案程序情况如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	项目备案情况	环评备案情况
1	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	43,615.04	43,615.04	津新津开投备案[2021]1号	津新津环备案[2021]18号
2	年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目	11,066.15	11,066.15	通发改开投备案[2021]18号	南通经济技术开发区行政审批局备案
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	-	-
	合计	74,681.19	74,681.19	-	-

二、募集资金投资项目市场前景分析
(一)我国半导体、集成电路产业发展潜力巨大
半导体产业作为电子元器件产业中最重要的组成部分,将直接影响国家科技产业发展,是国家重要的战略产业之一。当前,大数据、云计算、物联网、人工智能、车联网等信息产业快速发展,持续为半导体产业提供了强劲市场需求,也促使全球范围内半导体市场规模的不断扩大。中国作为全球制造业第一大国和全球电子信息产品消费第一大国,随着一系列国家战略和政策的加快推进,中国半导体产业将继续保持较高的发展速度。

集成电路是半导体产业的主要细分领域产品,诞生以来带动了全球半导体产业自20世纪60年代至90年代的迅猛增长。虽然我国集成电路产业起步较晚,但凭借巨大的市场规模、较低的生产成本以及经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件,我国集成电路产业近年来取得了快速发展。国家统计局数据显示,2018年我国集成电路产量达1,852.60亿块,2019年国内集成电路产量首次突破2,000亿块大关增至2,018.20亿块。

未来,随着大数据、云计算、物联网、人工智能、车联网等高新产业的不断发展,我国半导体和集成电路产业将拥有更加广阔的发展空间,市场潜力巨大,必将提升上游半导体、集成电路设备的市场需求。

(二)集成电路封装测试行业,有利于测试分选机行业的稳步发展
我国是全球最大集成电路生产国,其中,封装测试产业在我国占比比较大,同时,我国半导体产业链成熟领域的技术水平处于世界前沿。根据中国半导体行业协会数据,2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元,同比增长18.2%,2020年度,集成电路产业销售收入达8,848亿元,同比增长17%,封装测试产业贯穿集成电路设计、制造及封装的各个环节,探针台、测试机、分选机等测试设备的主要构成。

集成电路测试分选设备应用于芯片封装之后的终端环节,是提供芯片筛选、分类等功能的后道测试设备,也是芯片最终成品前的重要工序。随着集成电路产业的快速发展,集成电路测试分选机行业亦将得到快速发展。

(三)产业政策扶持为项目建设提供良好的发展环境
集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑国民经济和社会发展的战略性新兴产业和先导性产业。国家先后出台了一系列鼓励扶持政策,为集成电路产业建立了良好的政策环境。

2016年8月,国务院出台《关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》,要求建成一批引领性强、创新能力强的国际领军企业和具有国际影响力的产业化基地,造就一批具有较强国际竞争力的创新型领军企业,在部分领域或世界领先的高科技产业。2017年4月科技部颁布的《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》中指出“优化产业结构,推进集成电路及专用设备关键核心技术突破和应用”。2018年《国务院政府工作报告》指出要加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展,实施重大短板装备专项工程,推进智能制造、发展工业互联网平台。2020年1月份商务部等8部门印发的《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》将企业开展云计算、基础软件、集成电路制造、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划(专项、基金)等支持范围。

在国家对集成电路产业的大力支持下,随着相关政策法规不断完善和落实,以及云计算、物联网、大数据、工业互联网、人工智能、5G等新兴产业的迅速发展,我国集成电路技术将不断进步,行业未来将具有更加广阔的发展空间。在此背景下,集成电路设备制造行业将有望分享行业高速发展带来的巨大红利。

五、行业风险和其他重要事项

(一)行业风险
(一)半导体行业波动的风险
公司所处的集成电路专用设备行业不仅受宏观经济周期的影响,而且与消费电子、汽车电子、通信等行业终端应用领域的发展息息相关。如果全球宏观经济进入下行周期,或半导体产业链下游增长放缓,行业景气度下降,则半导体厂商可能会减少对于专用设备的投入,进而对公司的经营业绩带来不利影响。

(二)市场竞争加剧的风险
目前,来自欧美、日韩等国家的知名企业在国内集成电路测试分选设备市场仍然具有一定竞争优势。随着我国对集成电路行业发展的重视程度不断提高,国家出台了一系列支持和促进行业快速发展的政策,国内集成电路专用设备技术水平持续提升。近年来,国内生产设备的市场份额不断提升,进口替代趋势明显。

在集成电路测试分选设备行业快速增长、进口替代加速的大背景下,预期将有更多的企业进入该行业。若市场竞争加剧而公司无法保持自身技术优势,可能导致公司客户流失、市场份额降低,进而对公司业绩和盈利能力带来不利影响。

(三)国际贸易摩擦加剧的风险
报告期各期,公司境外销售收入分别为1,107.78万元、3,894.16万元、8,801.84万元和5,741.18万元,占主营业务收入比例分别为15.67%、21.41%、20.98%和27.20%。同时,目前公司部分原材料向境外供应商采购。2022年10月,美国商务部对中国先进计算机和半导体制造项目实施新的出口管制,若未来该等国际贸易摩擦进一步升级或境外客户所在地的贸易政策发生重大变化,将可能对公司未来销售及进口原材料的采购造成一定的负面影响,进而对公司的生产和经营业绩带来不利影响。

(四)经营风险
(一)客户集中度较高的风险
报告期内,公司前五大客户的销售收入占同期营业收入的比例分别为63.65%、66.09%、54.80%和68.83%,客户集中度较高。若公司未来市场拓展情况

不及预期,或公司不能通过技术创新、产品升级等方式及时满足客户的需求,亦或上述客户因自身经营状况发生变化,导致其对公司产品的采购需求下降,将可能对公司经营业绩产生不利影响。

(二)经营场所租赁风险
公司自成立以来始终从事集成电路测试分选设备的研发、制造和销售,公司自身涉及生产环节主要体现在整机设备定制方案设计、部分零部件的生产加工、软件的装配及调试、整机装配和调试等步骤。公司目前生产、办公场所等均通过租赁方式取得。若未来公司租赁合同到期后不能续约,将对公司正常生产经营造成一定影响。

三、技术风险
(一)技术研发风险
公司所处的集成电路专用设备行业属于技术密集型行业,产品研发涉及通信、精密电子测试、微电子、机械设计、软件算法、光子电子技术、制冷与低温工程等多种科学技术和学科知识的综合应用,具有较高的技术门槛。

公司主要从事集成电路测试分选设备的研发和制造,需要持续进行技术创新和产品研发,才能保持自身技术优势。如果未来公司不能紧跟集成电路专用设备制造领域的技术发展脚步,对关键前沿技术的研发无法取得预期成果;或无法准确把握市场需求的变化方向,充分满足客户多样化的需求,将可能导致公司产品缺乏竞争力、市场份额下降,进而对公司经营业绩产生不利影响。

(二)技术人员流失的风险
技术人员是公司持续进行研发创新并实现良好发展的关键,也是公司获得持续竞争优势的重要基础。随着行业竞争日趋激烈,公司对技术人才的需求与日俱增,若未来公司无法制定行之有效的激励机制,导致技术人才流失,或公司不能持续吸引适合公司业务发展的优秀人才,将对公司业务发展的持续带来不利影响。

(三)技术失密的风险
随着公司研发成果的持续积累和经营规模的进一步扩张,技术优势已经成为公司最为核心的竞争力之一。如果公司因核心技术人才流失、员工个人工作疏忽、外界窃取等原因导致公司核心技术失密,则可能对公司的技术先进性和产品竞争力产生不利影响,导致公司产品无法与市场同类产品进行差异化竞争,进而影响公司的盈利能力。

四、财务风险
(一)应收账款坏账损失的风险
报告期内,公司应收账款账面价值分别为3,917.49万元、7,127.84万元、13,632.27万元和15,538.56万元,占同期营业收入的比例分别为54.72%、38.49%、32.44%和36.81%。若未来市场环境发生变化,或公司主要客户的经营状况发生不利变化,则可能导致目前应收账款不能按期回收或无法全额收回而产生坏账,将对公司的经营业绩产生不利影响。

(二)存货跌价的风险
报告期各期末,公司存货账面价值分别为9,517.10万元、11,052.52万元、22,834.76万元和26,790.37万元,占流动资产的比例分别为54.55%、29.80%、29.46%和41.89%。公司存货规模增加主要是营业收入和生产规模增长较快、产品结构复杂所致。公司存货水平与公司所属行业特点、经营规模相适应。若市场发生重大变化,导致营业收入大幅下滑,则公司存在因某类产品发生滞销而导致的存货跌价风险。

(三)毛利率下降的风险
报告期内,公司综合毛利率分别为57.16%、57.62%、57.42%和57.89%。如果下游行业竞争持续加剧或上游行业原材料价格增幅较大,公司的综合毛利率可能会有所下降。此外,未来随着国内先进制造业的发展,如果公司不能持续提升技术创新能力并保持一定的领先优势,则公司综合毛利率也可能出现下降的风险。

(四)税收优惠政策变化的风险
报告期内,公司作为高新技术企业,按国家相关税收规定,适用企业所得税税率为15%。公司所得税优惠具有经常性损益,若公司未来不能持续符合高新技术企业资格条件,或者国家对于高新技术企业所得税相关政策发生调整,将对公司的利润水平带来不利影响。

(五)汇率波动的风险
报告期各期,公司境外销售收入分别为1,107.78万元、3,894.16万元、8,801.84万元和5,741.18万元,占主营业务收入比例分别为15.67%、21.41%、20.98%和27.20%。未来如果公司加大海外市场的开发力度,海外销售收入可能会进一步上升,汇率波动将影响发行人出口产品的销售价格,从而对发行人在海外市场的竞争力造成一定的影响。

五、募投项目实施的风险
(一)募投项目实施的风险
本次募集资金投资项目均围绕发行人主营业务进行,用于提高研发能力、扩大公司的生产能力、增强公司综合实力,包括“半导体测试设备智能制造及创新中心一期项目”和“年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”,拟投入募集资金金额为54,681.19万元。如果公司本次募投项目的建设进度、项目管理、设备供应等因素不达预期,将影响项目的投资收益,进而对公司的经营业绩产生不利影响。

(二)募投项目产能消化的风险
本次募集资金投资项目建成达产后,将形成年产500套测试分选设备和1,000台(套)测试分选设备机械零配件及组件的生产能力。若未来由于市场需求出现下降、行业竞争格局发生变化或发行人未来市场拓展不理想等原因导致公司募投项目新增产能无法完全消化,将影响项目的投资收益,进而对公司的经营业绩产生不利影响。

(三)新增固定资产投资折旧导致净利润下降及净资产收益率下降的风险
发行人此次募投项目“半导体测试设备智能制造及创新中心一期项目”和“年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”将新增固定资产和无形资产投资达8,026.55万元。两个项目实施后,公司生产模式无重大变化,投资规模将有所提高,预计每年增加折旧和摊销费用合计1,689.49万元,如项目实际效益低于预期,或者发行人未来运营效率不达预期,则新增折旧与摊销将对公司经营业绩带来不利影响。

同时,本次公开发行股票募集资金到位后,发行人的净资产将大幅增加,而本次募投项目尚需一定的建设期,难以在短期内为公司利润产生显著的贡献。因此,发行人存在发行后净资产收益率在短期内下降的风险。

六、其他风险
(一)新型冠状病毒疫情影响正常生产经营的风险
2020年初,新型冠状病毒疫情影响,致使全国各行各业遭受了不同程度的影响。为应对疫情,国家相关部门制定了有效疫情应急防控计划,实施各项防护措施,确保企业在抗击疫情的同时能够安全生产。

但随着疫情在全球范围扩散,部分国家和地区出现了疫情反复的情况。2022年4月,上海受到新型冠状病毒疫情的影响,公司在上海的生产基地亦受到一定影响。若国内部分地区疫情反复爆发,相关部门为疫情防控而施行人员隔离、交通管制等措施,可能对公司产品采购、组织生产和销售等经营活动造成一定障碍,进而对公司的业绩造成不利影响。

(二)股市波动的风险
股票价格的波动除受公司的盈利状况、发展前景等与公司自身生产经营相关的因素影响外,还受国际和国内宏观经济形势、货币政策、经济政策、市场环境、股票市场供求状况等诸多因素的影响,因此,股市存在频繁波动的风险。投资者在考虑投资本公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。如果投资者投资策略实施不当,可能会给投资者造成损失。

七、重大合同
截至本招股说明书摘要签署日,公司正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下:

(一)借款合同
截至本招股说明书摘要签署日,公司正在履行的借款合同情况如下:

序号	借款人	合同编号	借款金额(万元)	借款利率	合同期限	借款期限
1	中国农业银行股份有限公司上海分行	31010120220001354	2,000.00	LPK-30BPFS	2022.5.0	1年
2	上海银行股份有限公司天津分行	601220117	5,000.00	具体业务合同另行约定1.2	2022.8.10	1年
3	上海银行股份有限公司天津分行	601220130	1,800.00	票面利率20%的固定利率2	2022.2.8	1年
4	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	BE202209260002789	6,000.00	具体业务合同另行约定3.3	2023.10.24	1年

注1:上述第2项借款合同为综合授信合同,综合授信额度2,500万元,敞口额度1,500万元,额度可用于流动资金贷款、衍生品免保证金和银行承兑汇票,单笔业务期限不长于一年。

注2:上述第3项借款合同为银行承兑汇票承兑合同,合同约定发行人申请每笔承兑业务前,按不少于票面金额的20%交付存承兑保证金。

注3:上述第4项借款合同为综合授信合同,综合授信额度6,000万元,额度可用于银行承兑汇票和商票贴现等。

(二)销售合同
截至本招股说明书摘要签署日,公司正在履行的重要销售合同(合同金额700万元及以上)如下:

序号	客户名称	标的	合同签订时间	合同价款(含税,万元)
1	南通富微电子有限公司	测试分选机	20	